

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

股票名称：拓荆科技

股票代码：688072

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 其他（电话交流、网络会议等形式）
参与单位名称	天弘基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、工银瑞信基金、招商基金、富国基金、银华基金、交银施罗德基金、农银汇理基金、安信基金、宝盈基金、财通基金、诺安基金、民生基金、江信基金、华富基金、诺德基金、长安基金、圆信永丰基金、太平基金、鑫元基金、长信基金、东吴基金、东方阿尔法基金、东兴基金、创金合信基金、前海联合基金、国联基金、金信基金、富荣基金、施罗德投资（上海）、国寿资产管理、平安资产管理、华夏久盈资产管理、中国平安财产保险、友邦人寿保险、太平养老保险、交银人寿保险、中邮人寿保险、东吴人寿保险、鼎和财产保险、国任财产保险、招商证券、中信证券、华泰证券、中金公司、中国银河证券、国信证券、东方证券、光大证券、长江证券、兴业证券、方正证券、华西证券、山西证券、西部证券、太平洋证券、南京证券、开源证券、五矿证券、中天国富证券、英大证券、国投证券、金元证券、财信证券、国泰海通证券、平安证券、摩根士丹利、SEQUOIA CAPITAL、Point72、淡水泉投资管理、深圳市凯丰投资管理、巨杉资产管理（上海）、源峰基金、上海宽远资产管理、北京市星石投资管理、上海世诚投资管理、深圳聚鸣投资管理、上海同犇投资管理、上海丹羿投资管理、上海瀛赐私募基金、上海磐厚投资管理、上海紫阁投资管理、北京泓澄投资管理、深圳源乘投资管理、上海君和立成投资管理、上海明河投资管理、上海亘曦私募基金、上海运舟私募基金、上海见合私募基金、深圳市辰禾投资、深圳河床投资管理、上海朴拙投资管理、国泰君安证券资产管理、平安证券资产管理、广发证券资产管理、招商证券资产管理、杭银理财、上海国际信托、长江证券（上海）资产管理、山西证券资产管理、国信证券资产管理、三井住友资产管理（香港）、Nanyang Commercial Bank Limited、中信保诚资产管理、浙江龙航资产管理、上海复胜资产管理、上海敦颐资产管理、上海岳海资产管理、丰琰投资管理（浙江自贸区）、北京浦来德资产管理、北京神农投资管理、国新投资、华西银峰投资、国弘天下资本集团、上海竹润投资、上海森锦投资管理、上海瞰道资产管理、上海原点资产管理、上海璞远资产管理、伟星资产管理（上海）、上海见龙资产管理、浙江壁虎投资管理、北京方圆金鼎投资管理、上海左道投资管理、上海禾昇投资管理、深圳吉石资本、国亚金控资本管理、上海数联投资管理、HARMOLANDS CHINA EQUITY FUND、

	KS CAPITAL INVESTMENT FUND SPC、Astroll Investment、SCEP MANAGEMENT LIMITED、ELEVATION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、FIL HK-CHAPLT、Hao Capital、上海乾惕投资管理、上海禅龙资产管理、上海乘是资产管理、华商基金、民生加银基金、泰康基金、中邮基金、宏利基金、国投瑞银基金等
时间	2025 年 6 月 6 日至 2025 年 7 月 11 日
地点	沈阳、上海、北京、深圳
公司接待人员姓名	公司董事长：吕光泉 公司副总经理、董事会秘书：赵曦 公司证券事务代表：刘锡婷 公司投资者关系经理：曹辉
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节主要内容： 1. 公司产品线的布局和扩展策略？ 答：在设备品类方面，公司目前仍主要聚焦薄膜沉积设备（PECVD、ALD、Gapfill）、三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备，此外，公司通过投资参股等方式，布局覆盖了炉管式薄膜沉积、ALE（原子层刻蚀）等设备。从技术迭代方面，公司将持续高强度研发投入，围绕芯片前沿技术及客户的先进需求不断向纵深推进。 2. 请问公司在产业投资和并购重组等方面的布局和规划？ 答：公司近两年一直紧密围绕半导体产业链进行产业投资布局，开展了对恒运昌、新松半导体、珂玛科技、芯密科技、先锋精科等 10 余家公司的参股投资，助推我国半导体设备及零部件产业发展。同时，公司也在关注合适的标的，在未来的发展规划中，不排除通过并购契合公司战略、能够产生协同效应的优质标的助力公司业务的深度拓展，实现资源的高效整合与优化配置，进一步提升公司整体的市场竞争力。 3. 公司预计 2025 年的营业收入和净利润的规模？ 答：公司 2025 年的营业收入和净利润可详见后续定期报告。 4. 2025 年第二季度是否可以看到毛利率的回暖趋势？ 答：公司新产品在客户端已经逐步成熟，2025 年第二季度毛利率预计会呈现明显改善趋势。 5. 先进制程芯片扩产对公司订单需求量如何？ 答：公司多款新产品已在先进制程芯片产线中导入并通过客户验证，因此，如有先进制程芯片扩产，公司凭借先进产品的性能优势及深厚的技术积累，预计会获得较好的订单份额。 6. 公司键合设备产品布局和设备竞争力？

答：公司逐步完善应用于三维集成领域的半导体设备布局，包括先进键合产品及配套的量检测产品。（1）晶圆对晶圆键合产品：已实现量产并获得复购订单，其关键技术指标、产能指标与设备开机率均达到国际同类产品量产水平；（2）晶圆对晶圆熔融键合产品：可实现载片晶圆和器件晶圆低应力熔融键合，具备优异的产能表现，2024 年已经获得客户订单；（3）芯片对晶圆键合前表面预处理产品：已实现量产，目前该产品是国内唯一应用在芯片对晶圆生产线上的同类型设备；（4）芯片对晶圆混合键合产品：具有高精度、高产能、低污染的特点，2024 年该产品已获得客户订单并出货；（5）键合套准精度量测产品：可以实现混合键合后的键合精度量测，具有超高精度、超高产能和无盲区量测三大特点，已通过客户验证。（6）键合强度检测设备：主要应用于晶圆对晶圆键合强度检测，已通过客户验证。公司键合设备核心竞争力体现在设备类型的多元化，以及量产设备的关键技术指标、产能指标和设备开机率达到或超过国际同类产品水平。

7. 公司 PECVD 设备后续迭代升级的方式及工艺是什么？

答：公司通过对设备平台、反应腔、气体输送控制系统等优化设计，持续推出更高产能的设备平台及更高性能的反应腔，提升设备稳定性、设备产能、薄膜工艺均匀性、薄膜表面颗粒度等关键性能指标，满足下游客户持续提升的技术需求，同时，有助于提升客户产线的产能，减少客户产线的生产成本。

8. 公司产品的交货和验收周期时长？

答：根据产品不同、客户需求不同，订单交付时间不同。公司产品从签订订单到交付的周期通常为 3-6 个月。因为薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构的功能材料层，在芯片完成制造、封测等工序后一般会留存在芯片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能，所以，薄膜沉积设备在晶圆厂产线上所需要的验证时间一般较长（验证平均周期 3-24 个月）。

9. 公司目前人员规模大概是多少？如何吸引和留住人才？未来人才团队建设规划情况？

答：公司目前人员规模已超过 1500 人，已形成较为完善的人才引进和培养体系，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，同时，充分发挥股权激励机制的作用，增强公司人才团队的稳定性及凝聚力。未来公司将结合业务发展需要，持续加强人才梯队建设，扩大人员规模，一方面，公司将积极吸纳高校的优秀应届生，为公司注入创新活力，另一方面，积极引进经验丰富的资深人才，带领团队实现技术攻关，为公司的技术升级、产品优化等关键环节提供强有力的支撑。